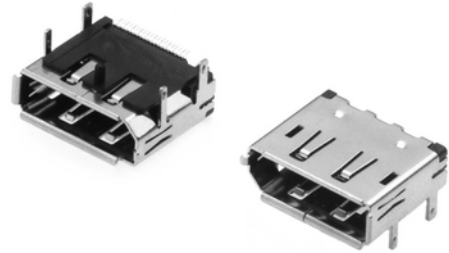
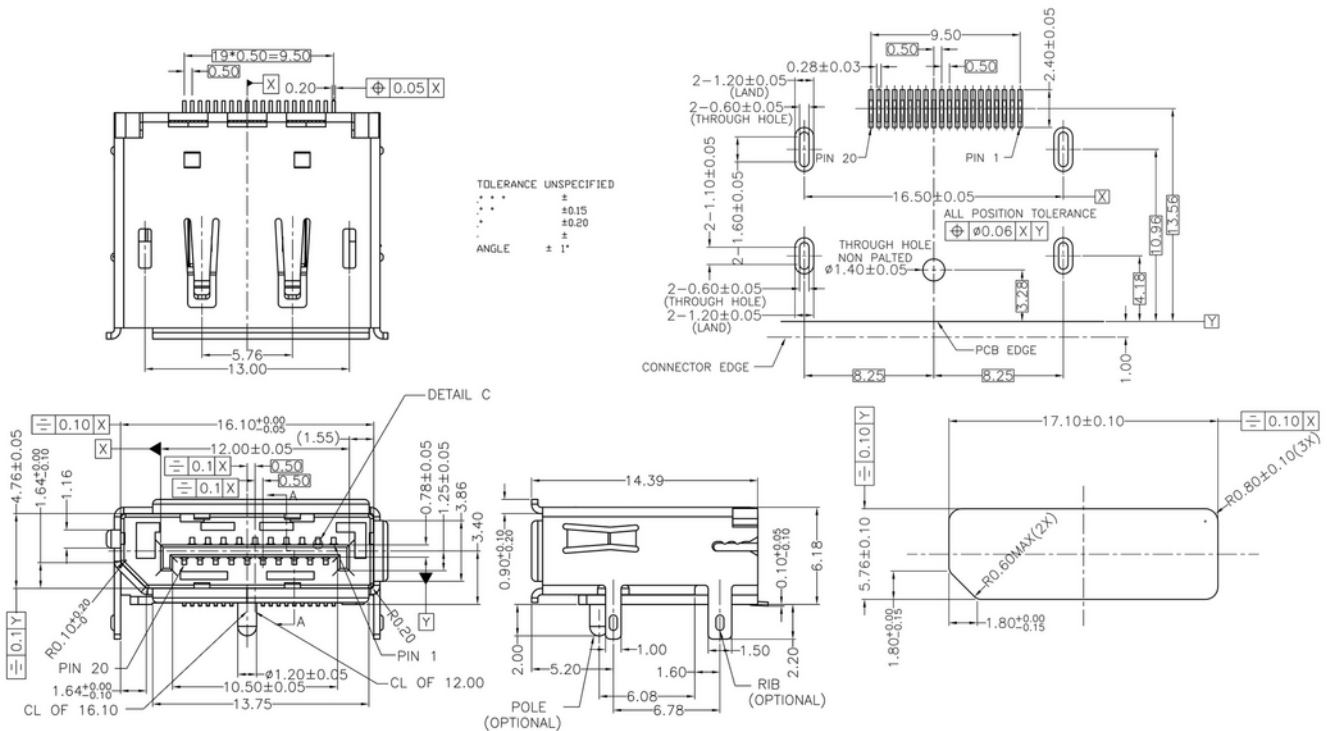


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Im Steckbereich vergoldet / Lötseite verzinkt
Contact Surface	Gold plated mating area / tin plated solder area
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS



Series	Type	Entry	Positioning*	Plating	Packing*
8470	2 2 Buchse Female	2 2 Gewinkelt Right-angled	1 1 mit Pos.hilfe, ohne Zungen w/ pos. peg, w/o latches 2 ohne Pos.hilfe, mit Zungen w/o pos. peg, w/ latches	80 80 sel. Au 0,75µm / Sn	00 00 TR

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut / Bulk good
TR = Tape & Reel (auf Anfrage) / Tape & Reel (on request)

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

